

報道関係各位

2017年6月2日

電子機器トータルソリューション展 2017 展示会本部事務局

[取材のご案内]

電子機器トータルソリューション展 2017
注目出展者によるプレス発表会を開催
会期中の6月7日(水)・8日(木)に17社が新技術・新製品を発表

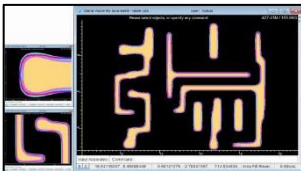
【取材のご案内】

◆会期中は展示ホール内にプレスセンターを開設いたします(東7ホール内)。展示会場と一体感が保てるスペースで、取材がスムーズに行えます。無線Wifi、各出展者資料、ドリンク・スナックサービスをご用意しております。

6月7日(水)から3日間、東京ビッグサイトで開催される「電子機器トータルソリューション展 2017 (構成展示会: JPCA Show/マイクロエレクトロニクスショー/JISSO PROTEC/ラージエレクトロニクスショー/WIRE Japan Show)」では、出展17社・団体によるプレス発表会を実施いたします。また7日(水)10:00からは、主催者による展示会概要、今年の見どころなどの発表を行います。読者の方へ展示会全体の様子を掲載いただく際の貴重な情報収集の場となりますので、出展ブースの取材とあわせぜひお立ち寄りください。

なお、出展者プレス発表の概要は次の通りです。(会場: 東7ホール プレスセンター隣 発表会会場)

【6月7日(水)発表の出展者】



●株式会社ステラ・コーポレーション <発表時間/10:30-11:00>

《新製品》 Keyword: エッチングシミュレーション、OPC技術

フォトマスクによるフォトレジスト露光時に、あらかじめ露光・現像後のパターン形状予測を可能にしたシミュレーションソフトウェアを紹介します。

●日本モレックス合同会社 <発表時間/11:05-11:35>

《新戦略》 Keyword: MID (成型相互接続デバイス)、LDS (レーザーダイレクトストラクチャリング)、3次元形状

MID技術で多くの実績を持ち、LDSは業界トップクラスの生産設備で展開。このたび強化した国内エンジニアサポート体制におけるMID市場への新展開について発表します。

●Shimada Appli 合同会社 <発表時間/11:40-12:10>

《新開発》 Keyword: 糸引き現象、塗布材スプレー

塗布材の糸引きを防止する新開発のスプレー塗布装置を紹介します。

●株式会社C-INK <発表時間/13:00-13:30>

《新製品》 Keyword: シールドインク、3次元形状、コスト削減

塗布するだけでプロセスが終了する独自開発のシールドインクを紹介します。

●ピーエス株式会社 <発表時間/13:35-14:05>

《新製品》 Keyword: 加湿器、温湿度管理、生産性向上

温湿度器設備の専門メーカーが新製品をご紹介します。

●**ハイウイン株式会社** <発表時間/14:10-14:40>

《新製品》 Keyword : グローバル、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001

ボールねじ、リニアガイドウェイ、リニアモータなど直動製品の専門メーカーが新製品をご紹介します。



●**東芝 IT コントロールシステム株式会社** <発表時間/14:45-15:15>

《新製品》 Keyword : X線非破壊検査、ナノフォーカス

実装基板、半導体業界の高密度化、3D実装化による高分解能のX線非破壊検査のニーズに応える装置を中心に紹介します。

●**株式会社 SCREEN PE ソリューションズ** <発表時間/15:20-15:50>

《新製品》 Keyword : 検査装置、HID 基板

欠陥検出精度の向上とイージーオペレーションを高いレベルで両立するハイエンドHDI基板向け光学式外観検査装置を紹介します。

●**株式会社 図研** <発表時間/16:00-16:30>

《新技術》 Keyword : MID (成型相互接続デバイス)、小型化、工数削減

部品実装の技術開発で改めて注目が高まるMIDの基板設計環境での対応を中心にご紹介します。

【6月8日(木) 発表の出席者】

●**アトテックジャパン株式会社** <発表時間/10:30-11:00>

《新製品》 Keyword : 次世代 IC サブストレート、ノンエッチング、伝送ロス低減

次世代 IC サブストレート向けに開発したノンエッチング密着補強プロセス「ノバボンド IT」を紹介します。

●**在日カナダ大使館** <発表時間/11:05-11:35>

《新戦略》 Keyword : カナダ、オープンイノベーション

世界の ICT 産業にとって屈指の投資先であるカナダの情報通信産業企業・投資優位性をご紹介します。



●**一般財団法人日本品質保証機構** <発表時間/11:40-12:10>

《新サービス》 Keyword : ISO/IEC 17025、JCSS、A2LA、校正、計量計測管理

ISO/IEC 17025 の認定を受けた校正機関として展開する多彩なサービスから、校正業務を中心に成果や今後の展開を発表します。

●**大阪府立大学** <発表時間/13:00-13:30>

《新技術》 Keyword : 金属ナノ粒子、薄膜形成、省資源、省エネルギー

金属ナノ粒子を種々の基板に並べ導電性薄膜をワンステップで形成する新技術をご紹介します。

●**富士通クオリティ・ラボ株式会社** <発表時間/13:35-14:05>

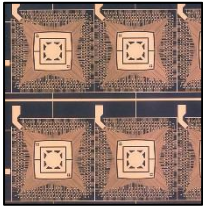
《新製品》 Keyword : カスタマイズ接着剤、短時間硬化、はんだペースト、省エネルギー

低温、短時間硬化特性や耐湿性、低発ガス性などに優れた接着剤のカスタマイズサービスと樹脂補強型の Sn-Bi 系低温はんだペーストを紹介します。

●**株式会社いおう化学研究所** <発表時間/14:10-14:40>

《新開発》 Keyword : 熱特性測定、放熱

正確な熱抵抗値や熱伝導率の測定を可能にした、接触界面熱抵抗値の小さい熱特性測定装置と放熱シートを紹介します。



●**太陽ホールディングス株式会社** <発表時間/14:45-15:15>

《**新技術**》 Keyword : 世界初、セルロースナノファイバー、電子部品絶縁材料、低熱膨張化
次世代新素材として注目される「セルロースナノファイバー (CNF)」を、世界で初めて電子部品用絶縁材料に使用可能な独自技術を紹介しします。

●**富士通インターコネクトテクノロジーズ株式会社** <発表時間/15:20-15:50>

《**新製品**》 Keyword : 半導体パッケージサブストレート、内蔵薄膜キャパシタ
内蔵薄膜キャパシタの容量を拡充した半導体パッケージサブストレートの技術、採用実績等を交え紹介しします。

[最新情報・詳細は、公式サイトをご覧ください。] <http://www.jpccashow.com>

■お問い合わせ

電子機器トータルソリューション展 2017 展示会本部事務局 (一般社団法人日本電子回路工業会)
E-mail : show@jpca.org TEL : 03-5310-2020 担当 : 清水川
電子機器トータルソリューション展運営事務局 (株式会社 JTB コミュニケーションデザイン内)
E-mail: jpcashow@jtbcom.co.jp TEL : 03-5657-0767 FAX 03-5657-0645
担当 : 鈴木、浅岡、旅河、田代

出展者プレス発表会 取材事前登録

下記のタイムテーブルより、取材を希望される出展社の□にチェックを入れ、
FAX もしくは PDF 等スキャンデータでご返信ください。
なお会場手配の都合上、登録は **6月6日(火)** を締め切りとさせていただきます。

以下出展者のプレス発表会を取材します。

当日は、会場にてお弁当をご用意いたします。ご希望の方はお申し込みください。
※出展者プレス発表会にご出席いただく方のみとなっておりますので、ご了承ください。

お弁当を 予約する 不要

[送信先] 電子機器トータルソリューション展運営事務局
FAX : 03-5657-0645 E-mail : jpcashow@jtbcom.co.jp

■ 出展者プレス発表会タイムテーブル

会場：東京ビッグサイト 東7ホール プレスセンター隣接 発表会会場

時間	6月7日(水)	6月8日(木)
10:00-10:20	<input type="checkbox"/> 主催者記者会見	——
10:30-11:00	<input type="checkbox"/> 株式会社ステラ・コーポレーション	<input type="checkbox"/> アトテックジャパン株式会社
11:05-11:35	<input type="checkbox"/> 日本モレックス合同会社	<input type="checkbox"/> 在日カナダ大使館
11:40-12:10	<input type="checkbox"/> Shimada Appli 合同会社	<input type="checkbox"/> 一般財団法人 日本品質保証機構
13:00-13:30	<input type="checkbox"/> 株式会社 C-INK	<input type="checkbox"/> 大阪府立大学
13:35-14:05	<input type="checkbox"/> ピーエス株式会社	<input type="checkbox"/> 富士通クオリティ・ラボ株式会社
14:10-14:40	<input type="checkbox"/> ハイウィン株式会社	<input type="checkbox"/> 株式会社いおう化学研究所
14:45-15:15	<input type="checkbox"/> 東芝 IT コントロールシステム株式会社	<input type="checkbox"/> 太陽ホールディングス株式会社
15:20-15:50	<input type="checkbox"/> 株式会社 SCREEN PE ソリューションズ	<input type="checkbox"/> 富士通インターコネクトテクノロジーズ株式会社
16:00-16:30	<input type="checkbox"/> 株式会社図研	——

媒体名：	
貴社名：	
部署：	役職：
氏名：	同行者： 名 ※カメラマンなど同行される方は人数をご記入ください。
TEL：	E-mail：